

SFS30(Aタイプ) 信頼性試験実績一覧表

EHB 4801
平成16年8月19日
コーセル株式会社
第二開発部 万尾

項番	試験項目	試験条件		判定条件	サンプル数	合格数
1	温度サイクル試験 (TC)	(1) 備考欄の前処理を行う (2) -40℃←→125℃各30分 (3) 600サイクル		(1) 試験前後で電気特性に異常がないこと (2) はんだ付け部にクラックがないこと	5	5
2	高温高湿 バイアス試験 (THB)	(1) 備考欄の前処理を行う (2) 85℃,85%Rh (3) 定格入力電圧印加 (4) 無負荷 (5) 1000時間		(1) 試験前後で電気特性に異常がないこと	20	20
3	振動・衝撃試験	振動	(1) $f=10\sim55\text{Hz}$: 49.0m/s^2 (2) 周期 : 3分間 (3) X,Y,Z各60分間	(1) 試験前後で電気特性に異常がないこと (2) はんだ付け部にクラックがないこと (3) 外観上著しい損傷がないこと	3	3
		衝撃	(1) 196.1m/s^2 (2) X,Y,Z各1回 (3) 11ms	(1) 試験前後で電気特性に異常がないこと (2) はんだ付け部にクラックがないこと (3) 外観上著しい損傷がないこと		
4	はんだ耐熱試験 (はんだゴテ)	(1) 360℃のはんだゴテで7secはんだ付けを実施 (2) 実装基板は $t=1.6$ のFR4を使用		(1) 外観及び端子はんだ付け部に上著しい損傷がないこと	1	1
5	静電気試験	(1) 印加電圧 $\pm 8\text{kV}$ (2) 定格入力電圧印加 (3) 定格負荷電流		(1) 保護回路の誤動作がないこと (2) 制御回路誤動作による出力電圧の低下がないこと (3) その他機能の誤動作がないこと	1	1

備考欄

前処理

- 手順1. 吸湿処理 : 85℃、60%Rh、168時間
 手順2. リフロー処理 : ピーク温度235℃、2回

No	Test Item	Testing conditions	Conditions of acceptability	Number of samples	Number of failures
1	Heat cycle test 温度サイクル試験 (TC)	(1) Pre-process 前処理 Step1 Humidifying processing (85°C,60%,168H) 手順1. 吸湿処理 (85°C,60%,168H) Step2 Reflow soldering (Peak temperature 245°C,2times) 手順2. リフロー処理 (ピーク温度 245°C,2回) (2) -40°C ~ 125°C 30minutes each -40°C ~ 125°C 各30分 (3) 600 cycles 600サイクル	(1)No degradation of electric characteristics after test. 試験前後で電気特性に異常がないこと (2)No crack at solder joint はんだ付け部にクラックがないこと	5	0
2	High temperature/ High humidity bias test 高温高温バイアス試験 (THB)	(1) Pre-process 前処理 Step1 Humidifying processing (85°C,60%,168H) 手順1. 吸湿処理 (85°C,60%,168H) Step2 Reflow soldering (Peak temperature 245°C,2times) 手順2. リフロー処理 (ピーク温度 245°C,2回) (2) Ta=85°C, RH=85% 周囲温度85°C、湿度85% (3) At rated input 定格入力時 (4) Load 0% 無負荷 (5) 1000 hours 1000時間	(1)No degradation of electric characteristics after test. 試験前後で電気特性に異常がないこと	10	0
3	Vibration test 振動試験	(1) $f=10\sim55\text{Hz}$ $49.0\text{m/s}^2(5\text{G})$ 周波数=10~55Hz 49.0m/s ² (5G) (2) 3minutes period 周期 3分 (3) 60 minutes each along X,Y and Z axis X,Y,Z方向 各60分	(1)No degradation of electric characteristics after test. 試験後、諸機能が正常であること (2) No crack at solder joint. はんだ部にクラックがないこと (3) No marked damage of appearance. 外観上著しい破損がないこと	3	0
4	Impact test 衝撃試験	(1) $196.1\text{m/s}^2(20\text{G})$ 11ms (2) Once each X,Y and Z axis X,Y,Z方向 各1回	(1)No degradation of electric characteristics after test. 試験後、諸機能が正常であること (2) No crack at solder joint. はんだ部にクラックがないこと (3) No marked damage of appearance. 外観上著しい破損がないこと	3	0
5	Soldering heat test はんだ耐熱試験 (はんだゴテ)	(1) Soldering iron 360°C,7seconds 360°Cのはんだゴテで7秒、はんだ付けを実施 (2) Mounting board : $t=1.6\text{mm}$ / FR-4 実装基板は $t=1.6$ のFR-4を使用	(1)No crack at solder joint はんだ部にクラックがないこと (2)No marked damage of appearance. 外観上著しい破損がないこと	1	0
6	Static electricity immunity test 静電気放電イミュニティ試験	(1) Applied voltage $\pm 8\text{kV}$ 印加電圧 $\pm 8\text{kV}$ (2) At rated input and load 定格入力・定格負荷 (3) Applied pin : 印加ピン SFS:Input and Output SFS: 入力、出力 SFCS:Input, Output and Case SFCS: 入力、出力、ケース	(1)The power supply is not stop. 停止しないこと (2)Circuit does not malfunction. 誤動作のないこと (3)No abnormality of the insulation destruction etc. 絶縁破壊など故障がないこと (4)Parts are no damaged. 部品の故障がないこと	1	0

Approved : *Toshiyuki Tsuru*
Toshiyuki Tsuru

Prepared : *K. Shibutani*
Kenichi Shibutani